

# Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz

**Ihr Ansprechpartner**  
Jens Jungmann

**Durchwahl**  
Telefon +49 351 564 80600  
Telefax +49 351 564 80680

presse@smwa.sachsen.de\*

07.09.2023

## Statement von Wirtschaftsminister Martin Dulig zur Gründung der Allianz europäischer Halbleiterregionen

**»Europäische Zusammenarbeit stärkt die industriellen Kerne –  
davon profitiert auch das Silicon Saxony!«**

Auf Initiative des Freistaates Sachsen hat sich heute in Brüssel die Allianz europäischer Halbleiterregionen ESRA gegründet (European Semiconductor Regions Alliance). Die Vereinigung aus rund 20 Halbleiterregionen versteht sich als regionale Plattform und Partner der Europäischen Kommission bei der Umsetzung des European Chips Act. Sie will einen aktiven Beitrag zur Stärkung Europas als Halbleiterstandort im globalen Wettbewerb leisten. Dazu sagt der sächsische Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulig:

»Die wirtschaftliche Transformation ist in vollem Gange. Es geht darum, wie wir die Industrie in das 21. Jahrhundert bringen – und da spielt das Thema Mikroelektronik eine ganz entscheidende Rolle. Deshalb ist Sachsen als führender europäischer Halbleiterstandort prädestiniert, sich europäisch zu vernetzen. Die Allianz europäischer Halbleiterregionen hilft uns, die weitreichende Bedeutung des Themas Mikroelektronik in Europa zu stärken und Kooperationen zu organisieren.

Digitalisierung, Energiewende, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz – diese brennenden Herausforderungen meistern wir nur, wenn die dafür benötigten Chips jederzeit verfügbar sind. Gegenwärtig geht es vor allem darum, sich aus der hohen Abhängigkeit vom amerikanischen und insbesondere vom asiatisch/chinesischen Markt zu lösen.

Um die Wertschöpfung auf dem Kontinent zu halten und unsere industriellen Kerne zu stärken, bedarf es also einer starken europäischen Kooperation und Produktion. Mit seinem Know-how und seinen tiefgreifenden Erfahrungen bei der wirtschaftlichen Transformation seit der Wiedervereinigung wird sich Sachsen in die Allianz einbringen, das Bündnis zum Erfolg führen und selbst davon profitieren.«

**Hausanschrift:**  
**Sächsisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Arbeit, Energie  
und Klimaschutz**  
Wilhelm-Buck-Straße 2  
01097 Dresden

[www.smwa.sachsen.de](http://www.smwa.sachsen.de)

Zu erreichen ab Bahnhof  
Dresden-Neustadt mit den  
Straßenbahnlinien 3 und 9, ab  
Dresden-Hauptbahnhof mit den  
Linien 3, 7 und 8. Haltestelle  
Carolaplatz.

\* Kein Zugang für verschlüsselte  
elektronische Dokumente. Zugang  
für qualifiziert elektronisch signierte  
Dokumente nur unter den auf  
[www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html](http://www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html)  
vermerkten Voraussetzungen.

Mit Blick auf die Subventionen für die Halbleiterindustrie betont Martin Dulig:

»Wenn die Halbleiterhersteller für ihre neuesten Chip-Generationen Fertigungsstandorte suchen und dafür Neuansiedlungen planen, erwarten sie angemessene öffentliche Unterstützung. Hier gilt es, auch im internationalen Wettbewerb gegen konkurrierende Programme zu bestehen – etwa mit den USA und den dortigen Förderangeboten. Ansiedlungen, die jetzt außerhalb von Europa geschehen, können wir später nicht nachholen.

Von den Milliarden, welche die EU und der Bund in die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chipindustrie investieren, profitieren langfristig wir alle. Allein die Effekte der Jahrhundert-Investition von TSMC für die Bauwirtschaft, das Handwerk, den Handel, die Weiterentwicklung unserer Verkehrsinfrastruktur und die demografische Entwicklung durch den Zuzug von Fachkräften können wir nicht hoch genug schätzen. Durch Folgeeffekte ist mit dem Ausbau von weiteren Unternehmensstandorten und zusätzlichen Neuansiedlungen in Sachsen zu rechnen.«

## Hintergrund

Jeder dritte in Europa produzierte Chip kommt bereits aus dem Silicon Saxony. Aktuell arbeiten rund 76.000 Beschäftigte in der sächsischen Mikroelektronik- und IKT-Branche. Die in diesem Jahr verkündeten Investitionsentscheidungen von TSMC und Infineon stärken dieses einzigartige Halbleiter-Ökosystem aus Industrie und Spitzenforschung. Mit TSMC – die größte Einzelinvestition eines Unternehmens in Sachsen seit 1990 – wird der Freistaat endgültig zum globalen Halbleiterstandort. Somit festigt das Silicon Saxony zugleich die Widerstandskraft des gesamten Industriestandorts Europa im globalen Wettbewerb.

## Übersicht: Großinvestitionen am Wirtschaftsstandort Sachsen

- 1991: Die **Volkswagen AG** investiert in Zwickau-Mosel ca. 1,2 Milliarden Euro (heute ca. 9.800 Mitarbeiter in ganz Sachsen). Mehrere Milliarden Euro wurden seitdem in das Werk investiert, zuletzt beim Umbau zum Leitwerk für E-Fahrzeuge (über eine Milliarde Euro).
- 1994: Investitionsentscheidung von **Siemens** (seit 1999: '*Infineon Technologies Dresden* ' GmbH & Co. OHG) für Chipfabrik in Dresden | Investitionssumme: ca. 1,5 Milliarden Euro
- 1995: Investitionsentscheidung von **AMD** (seit 2009: **Globalfoundries**) in Dresden | Investitionssumme: ca. 2,4 Milliarden Euro
- 1998: Investitionsentscheidung von **TDDK** in Straßgräbchen für Klimakompressorenwerk | heute 950 Mitarbeiter mit aktuellem Ausbauprojekt
- 1999: Entscheidung der **Porsche AG** für einen Werksneubau in Leipzig (heute 4.400 Mitarbeiter). Bis 2019 hat Porsche mehr als 1,3 Milliarden Euro in die Entwicklung des Werks investiert. 2019 startete die fünfte Erweiterung (mehr als 600 Millionen Euro).

- 1999: Entscheidung der **Volkswagen AG** zur Errichtung der Gläsernen Manufaktur in Dresden | Investitionssumme: ca. 900 Millionen Euro
- 2001: Entscheidung der **BMW AG** für einen Werksneubau in Leipzig | ca. 1,2 Milliarden Euro Anfangsinvestition, heute 5.500 Mitarbeiter
- 2002: Aufbau einer Wafer-Produktion der **Siltronic AG** in Freiberg | Investitionssumme: 430 Millionen Euro, Schaffung von 650 Arbeitsplätzen
- 2003: Investitionsentscheidung der **DHL Hub Leipzig GmbH** für den EURO Cargo Hub | Investitionssumme: ca. 285 Millionen Euro, Schaffung von 4.000 Arbeitsplätzen
- 2004: Investitionsentscheidung von **AMD** (seit 2009: **Globalfoundries**) für »Module One« | Investitionssumme: ca. 2,8 Milliarden Euro
- 2007: Investitionsentscheidung von **AMD** (seit 2009: **Globalfoundries**) für »Module Two« | Investitionssumme: ca. 2,4 Milliarden Euro
- 2017: Investitionsentscheidung von **Bosch** für Errichtung einer Chipfabrik in Dresden | Investitionssumme: eine Milliarde Euro, 700 Arbeitsplätze
- 2021: Investitionsentscheidung der **Beiersdorf AG** für Produktionsfabrik und Logistik-Hub | Investitionssumme: 390 Millionen Euro, 600 Arbeitsplätze
- 2023: Erweiterungsentscheidung der **Infineon AG** für eine Smart Green Power Fab | Investitionssumme: fünf Milliarden Euro, 1.000 neue Arbeitsplätze
- 2023: Ankündigung des Halbleiterherstellers **TSMC** für den Bau einer Halbleiterfabrik in Dresden (Joint Venture mit Bosch, Infineon und NXP) | geplante Gesamtinvestitionen: zehn Milliarden Euro